

## BAS40

### 肖特基二极管芯片(4 " )

■用途:

高速开关应用  
电路保护  
电压箝位

■特征:

- \* 正向压降小
- \* 结电容小
- \* 适用于片式封装
- \* 有效图形数 133600 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	230 μ m×230 μ m
压焊区尺寸	120 μ m×120 μ m
芯片厚度	180±20 μ m
锯片槽宽度	40 μ m
金属层	正面:Al 2.3±0.2μm 背面:Au 1.4±0.2μm

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小	最大	典型值	单位
正向压降	V <sub>F1</sub>	I <sub>F</sub> =1mA		0.38	0.33	V
	V <sub>F2</sub>	I <sub>F</sub> =40mA		1.0	0.70	V
反向击穿电压	V <sub>R</sub>	I <sub>R</sub> =10 μ A	40		50	V
反向漏电流	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =30V		0.2		μ A
结电容	C <sub>j</sub>	V <sub>R</sub> =0V,f=1MHZ		5		PF
反向恢复时间	t <sub>rr</sub>	I <sub>F</sub> =I <sub>R</sub> =5mA,R <sub>L</sub> =100 Ω ,I <sub>RR</sub> =0.1 I <sub>R</sub>		5		ns